

《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》征文通知

近年来，中国覆铜板行业大力推进发展高技术覆铜板，如高导热、高散热、高耐热性、高频、高速覆铜板、无胶挠性覆铜板等新产品，在多个企业投入研发或量产，封装基板用覆铜板也已经正式面市。种种迹象表明，我国的高技术覆铜板正在酝酿着重大突破。CCLA（中国电子材料行业协会覆铜板分会）连续十七年组织召开《中国覆铜板技术·市场研讨会》，提供国内外覆铜板业界进行技术信息交流，以促进我国覆铜板技术的持续发展。

第十八届中国覆铜板技术研讨会于**2017年11月8日至10日**在**广东东莞尼罗河酒店**召开。现在开始征文，具体要求如下：

一、论文征集范围及内容：

覆铜板、设备、仪器、上游原材料、下游印制板、终端整机电子产品等相关行业人士，均可撰写论文应征。论文可在制造技术、研究开发、应用、节能、环保等方面选定某一专题后，进行深入论述；基础理论、应用技术、前沿技术等内容均可。可以参考以下课题：

- 1、上下游协同创新，提升覆铜板产业链整体水平的机制、政策研究；
- 2、电子整机（可限定某种整机如高端智能手机等）、集成电路芯片、载板、汽车电子等对高性能高可靠性覆铜板要求解析；
- 3、微波电路高频、高速覆铜板研究；用于 IED 照明的高导热、高耐热、高尺寸稳定性覆铜板，IC 载板用覆铜板，高性能挠性覆铜板等产品研究/制造/测试技术及成果；
- 4、高性能覆铜板原材料研究/制造/测试技术及成果；
- 5、标准、环保课题研究及成果；
- 6、覆铜板设备开发研究及改造。

二、论文格式要求：

- 1、论文应包括题目、内容摘要、关键词、正文、参考资料、作者姓名、单位、主要作者简介（联络事项）；
- 2、论文正文字数 5000~8000 字。

三、论文征集截止时间：

- 2017 年 **8 月 18 日前**，提供论文题目、内容摘要；
2017 年 **9 月 30 日前**，提供论文全文 Word 电子版。

四、论文入选程序：

组委会将评审通过的论文收录进论文集，供会议代表交流（该文集是中国知识资源总库—中国重要会议论文全文数据库收录文献，如作者不愿被收录，请声明；凡不声明者，即视为同意收录）。评选出的优秀论文将进行大会讲演。组委会于 2017 年 10 月 15 日前，通知作者论文是否被收录或被选为大会讲演论文。凡被收录的论文，在本届大会召开前，请勿在其他会议上发布。选为大会讲演的论文，于 2017 年 10 月 25 日前提供 PPT。提交的论文，无论采用与否，一律不予退回，请作者自留底稿。

五、组委会联络事项：

联系人：李小兰 电话：029-33335234 ， 18089181587

E-mail: ccla33335234@163.com

《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》组委会

覆铜板材料分会
2017年8月5日

